



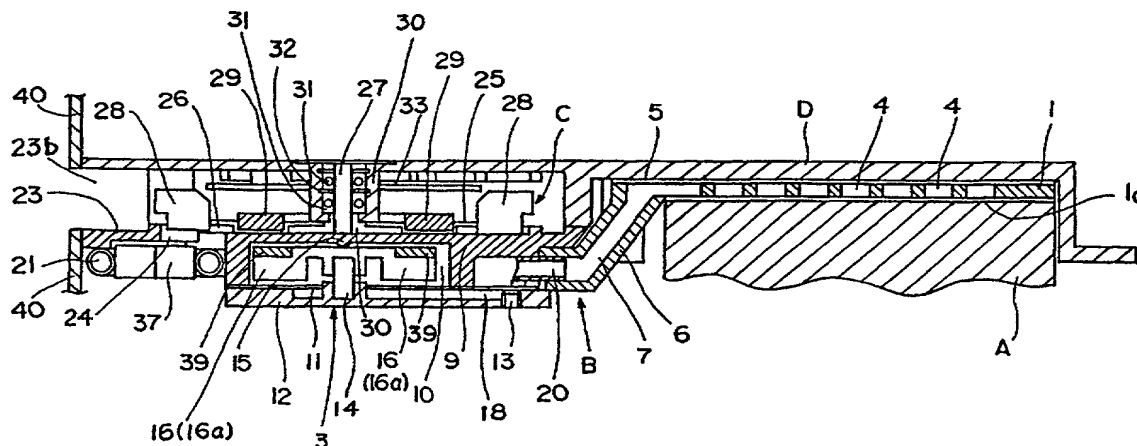
PCT

特許協力条約に基づいて公開された国際出願

<p>(51) 国際特許分類6 F25D 9/00, H05K 7/20</p>	<p>A1</p>	<p>(11) 国際公開番号 WO00/52401</p> <p>(43) 国際公開日 2000年9月8日(08.09.00)</p>
<p>(21) 国際出願番号 PCT/JP99/00940</p> <p>(22) 国際出願日 1999年2月26日(26.02.99)</p> <p>(71) 出願人 (米国を除くすべての指定国について) 日本サーモスタット株式会社 (NIPPON THERMOSTAT CO., LTD.)[JP/JP] 〒204-0003 東京都清瀬市中里6丁目59番地2 Tokyo, (JP)</p> <p>(72) 発明者; および</p> <p>(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ) 魚森康治(UOMORI, Yasuharu)[JP/JP] 高橋正規(TAKAHASHI, Masanori)[JP/JP] 伊東 聡(ITO, Satoshi)[JP/JP] 〒204-0003 東京都清瀬市中里6丁目59番地2 Tokyo, (JP)</p> <p>(74) 代理人 弁理士 木下 茂(KINOSHITA, Shigeru) 〒210-0912 神奈川県川崎市幸区中幸町4丁目42番地 金子ビル4階 Kanagawa, (JP)</p>		<p>(81) 指定国 AU, CA, CN, JP, KR, MX, SG, US, 欧州特許 (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE)</p> <p>添付公開書類 国際調査報告書 補正書・説明書</p>

(54) Title: COOLING DEVICE OF ELECTRONIC DEVICE

(54) 発明の名称 電子機器の冷却装置



(57) Abstract

A cooling device of electronic device, comprising a liquid cooling mechanism (B) formed by providing liquid flow paths (4) in a heat absorber (1) in contact with an electronic device (A) and providing metal pipes (20 and 21) for connecting a pump (3) which feeds cooling liquid by the rotation of an impeller (16) to the liquid flow paths (4) and a forced-air cooling mechanism (C) formed by providing radiating fins (37) on the outer surfaces of the metal pipes (20 and 21), and providing a fan to exhaust air inside the metal pipes (20 and 21) with radiating fins (37) thereon and a cabinet to the outside thereof, the fan (25) and impeller (16) being provided with magnets (29 and 39), respectively, so as to simplify and downsize the structure of a drivingly rotating mechanism.